

2024 法人說明會

總經理 黃道景 2024.9.19

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明



本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。

公司簡介

創立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

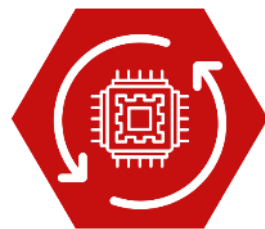


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備

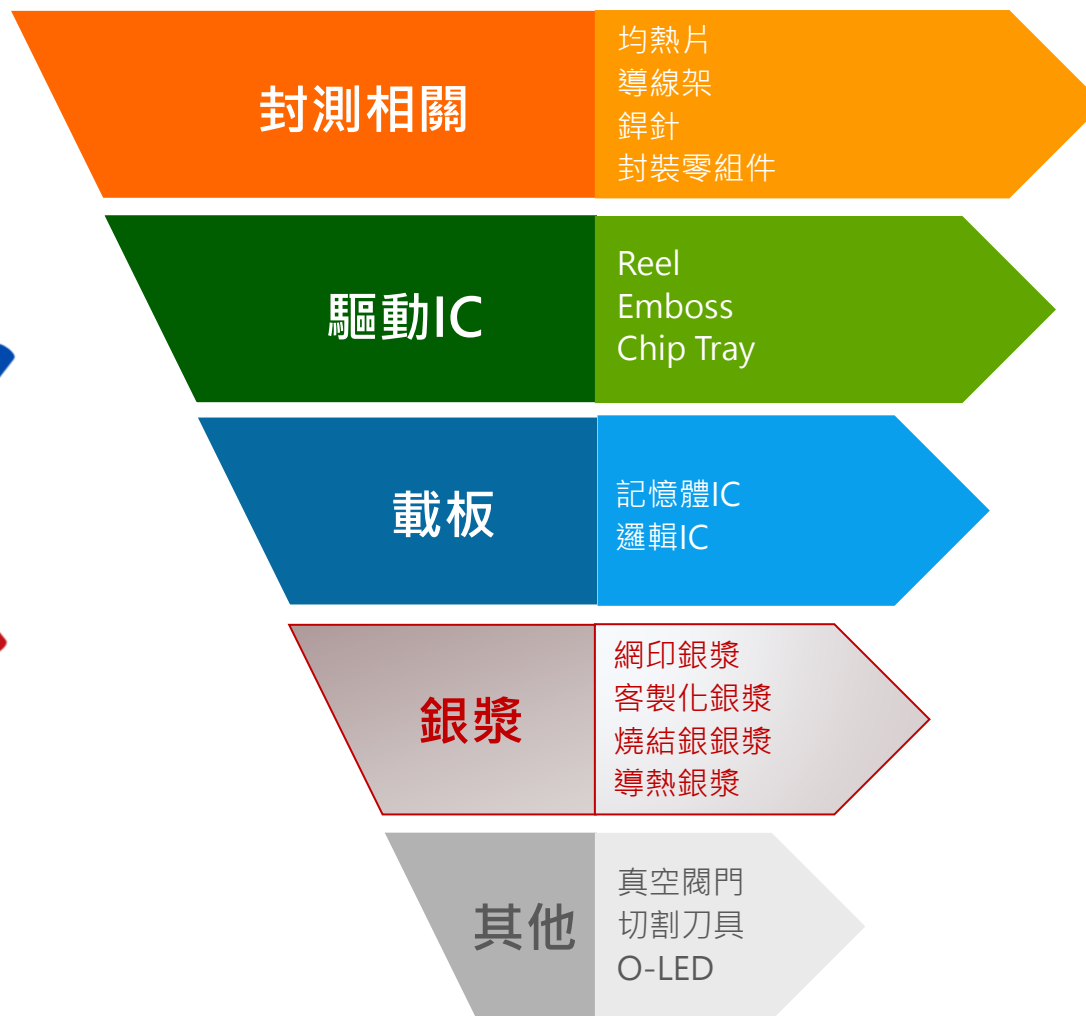
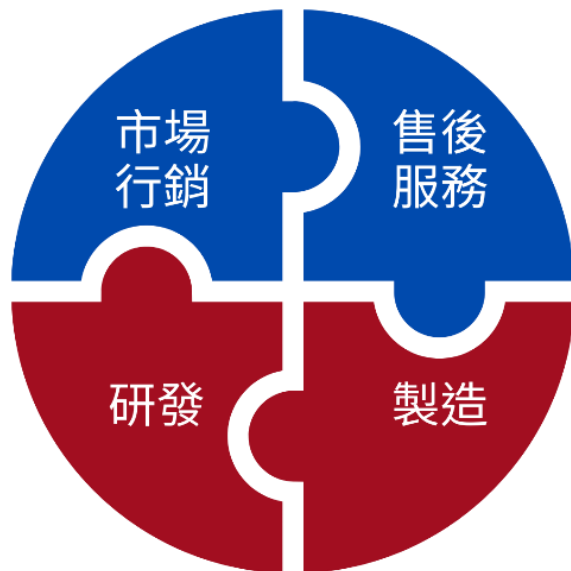


自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿

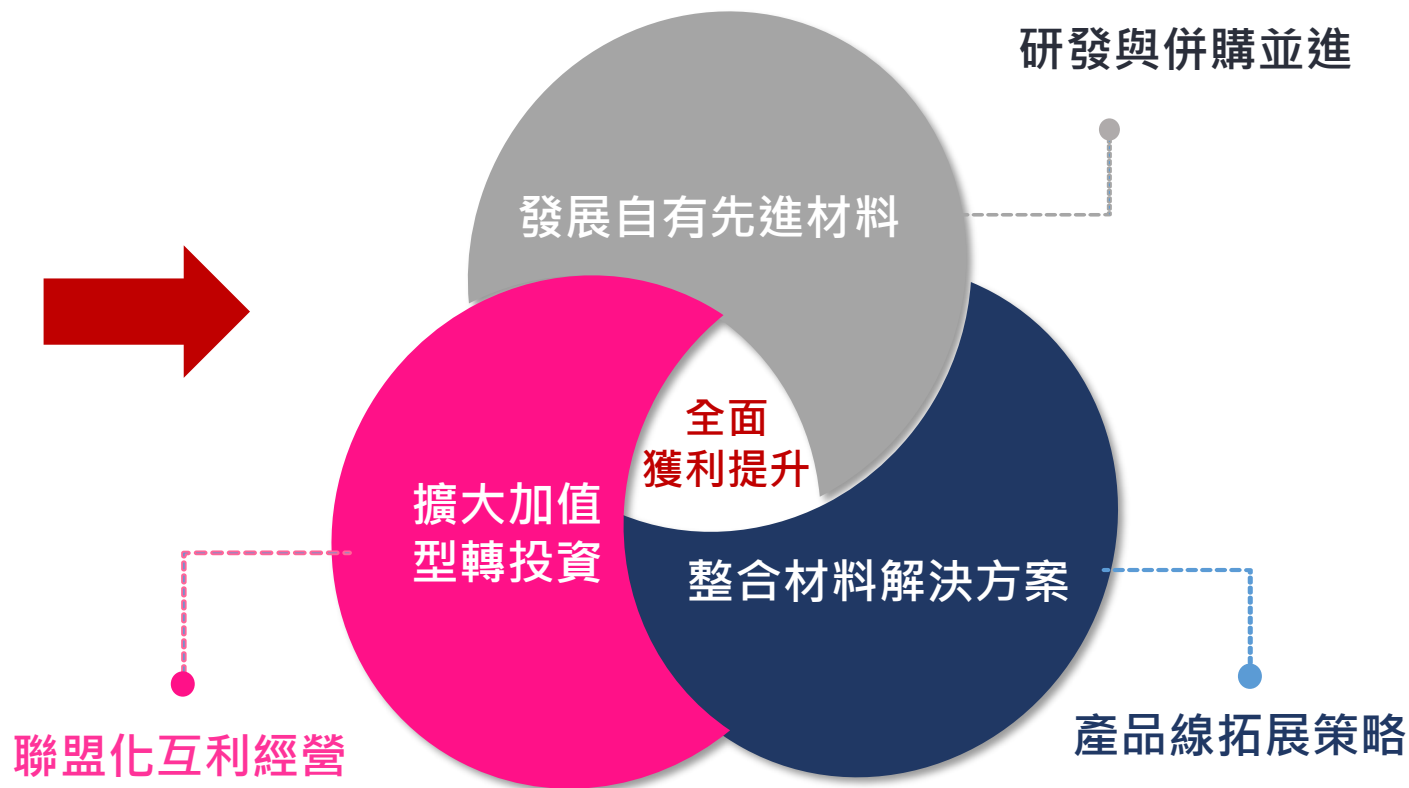
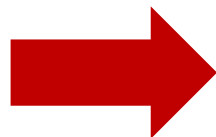
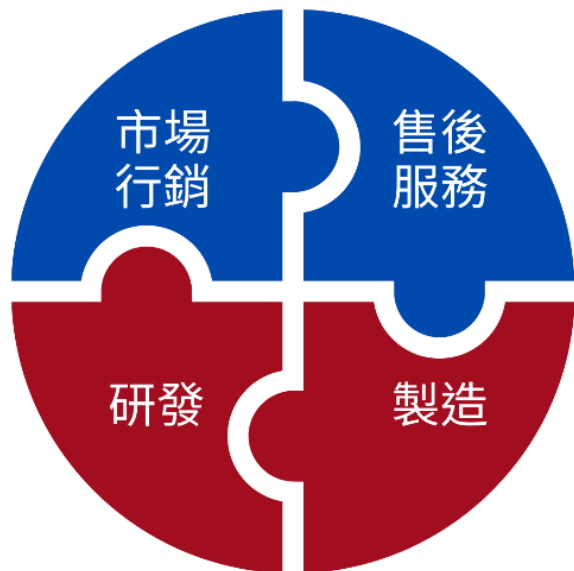
營運三布局(1/2)

代理商 → 整合型材料供應商



代理商 ➔ 整合型材料供應商

轉型全面提升獲利





營運報告

綜合損益表



(NT\$仟元)	2022	2023	1Q 2024	2Q 2024	1H 2024	2Q 2024		1H 2024
						QoQ	YoY	YoY
營業收入	1,060,398	976,397	238,074	301,397	539,471	27%	16%	15%
營業毛利	310,949	255,756	63,037	73,889	136,926	17%	10%	11%
毛利率	29%	26%	26%	25%	25%	-4%	4%	-2%
營業淨利	124,057	75,279	13,241	21,977	35,218	66%	-1%	15%
營業外收(支)	110,067	36,565	23,801	14,426	38,227	-39%	-17%	24%
稅前淨利	234,124	111,844	37,042	36,403	73,445	-2%	-8%	19%
本期淨利	195,976	93,545	31,079	33,013	64,092	6%	4%	21%
淨利率	18%	10%	13%	11%	12%	-16%	-9%	6%
EPS (NT\$)	5.01	2.16	0.69	0.73	1.42	6%	4%	16%

資產負債表



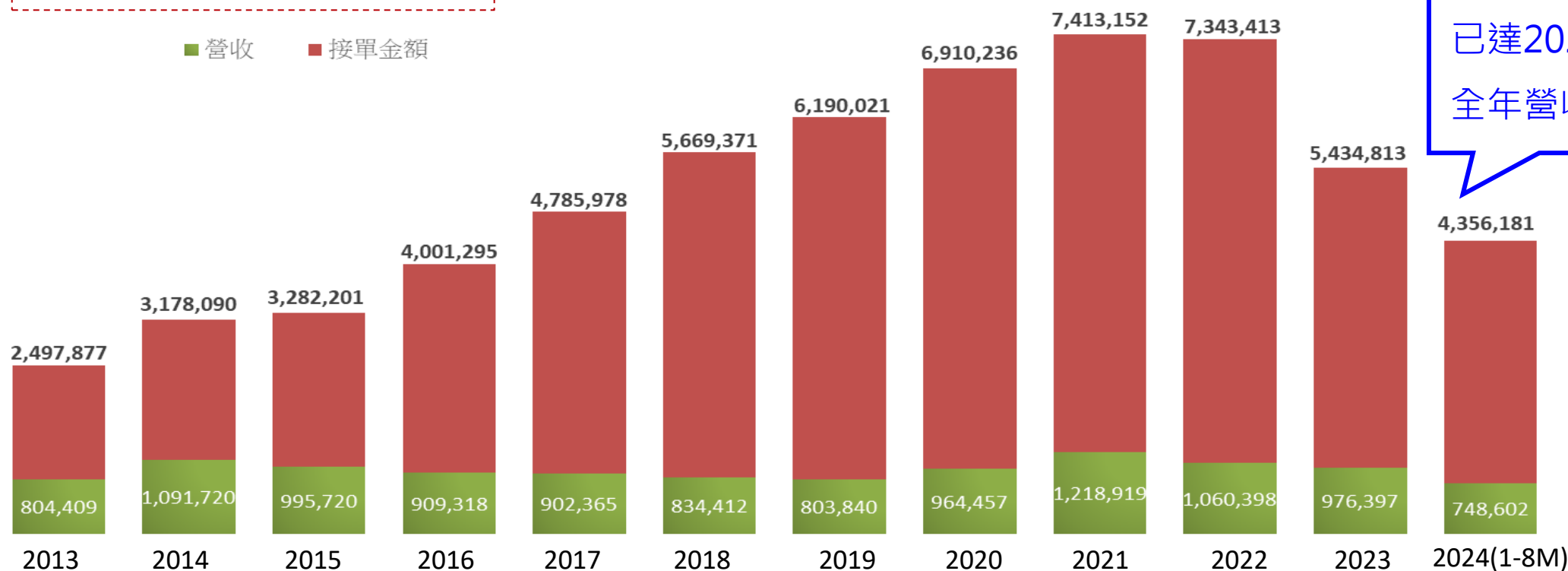
NT\$仟元	2020	2021	2022	2023	1H 2024
資產					
現金及約當現金	170,088	279,765	327,431	398,797	326,883
應收帳款	597,702	509,553	532,247	443,432	515,364
存貨	47,736	66,764	60,048	67,008	48,992
轉投資相關	188,357	205,830	257,247	263,434	289,645
不動產、廠房及設備	227,025	228,528	226,154	223,341	282,946
其他資產	71,074	23,817	26,539	34,288	30,577
資產總計	1,301,982	1,314,257	1,429,666	1,430,300	1,494,407
負債					
短期借款	224,782	126,429	150,000	-	-
應付帳款	240,718	265,051	227,968	233,559	263,109
其他負債	99,569	115,613	131,435	110,272	195,373
負債總計	565,069	507,093	509,403	343,831	458,482
權益總計	736,913	807,164	920,263	1,086,469	1,035,925
淨值 (NT\$元)	18.84	20.64	23.53	24.63	23.48

歷年營收/接單金額



單位：仟元

2013-2023 CAGR(複合成長率)
營收：2%
接單金額：8.1%

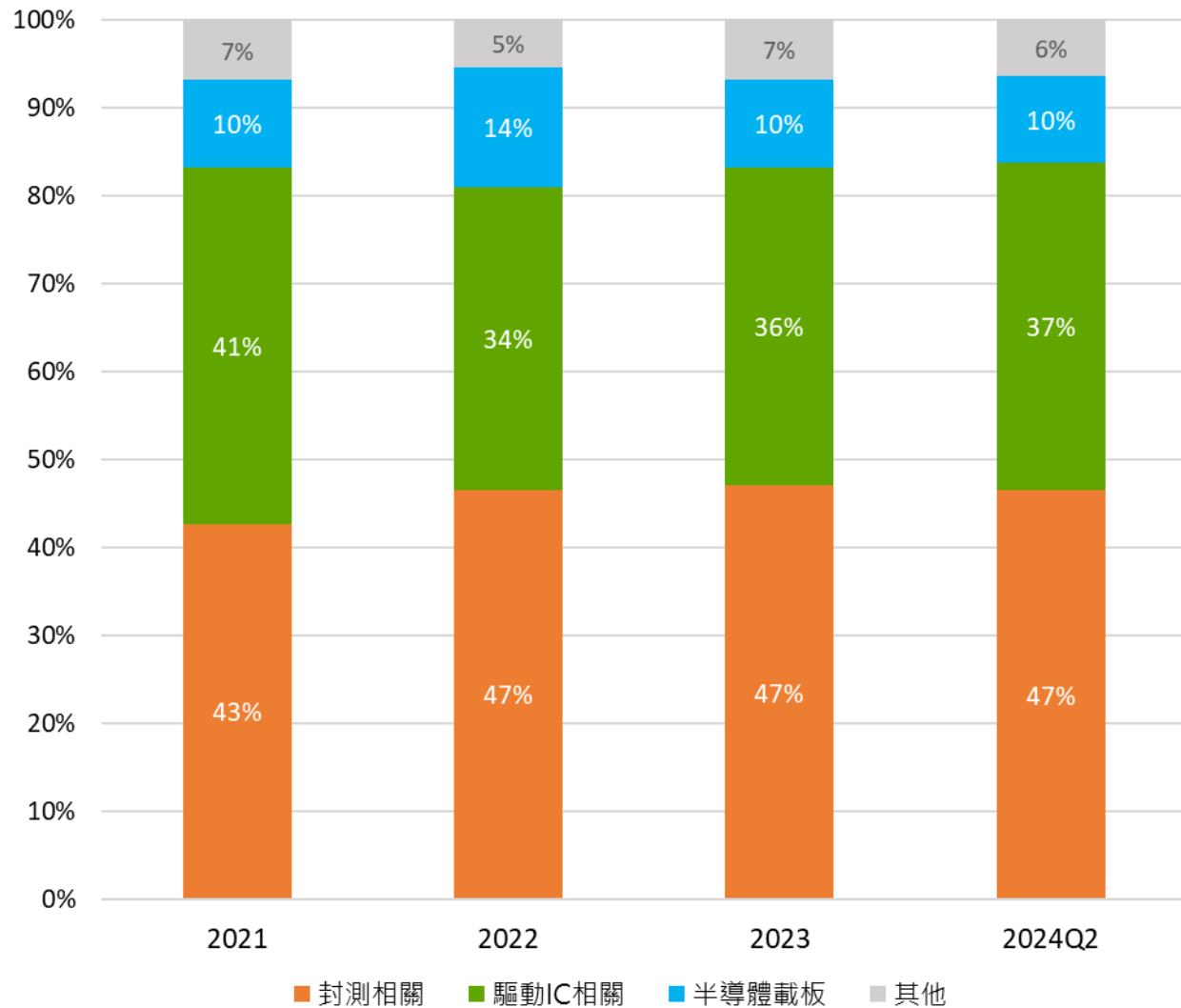


已達2023年
全年營收77%

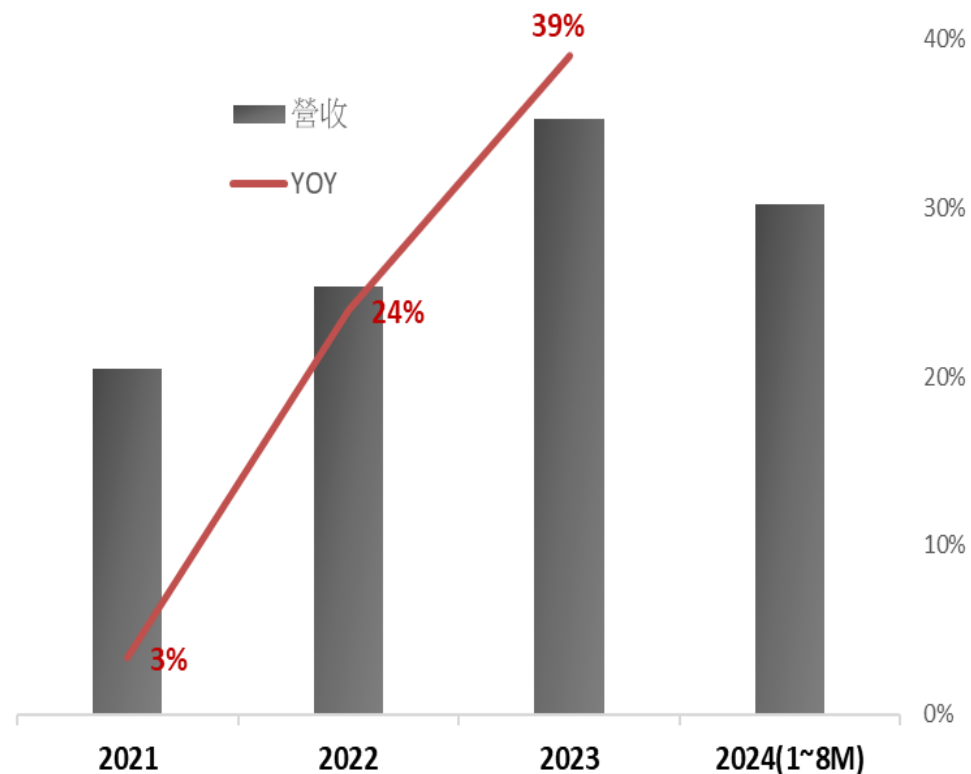
說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

產品別營收佔比



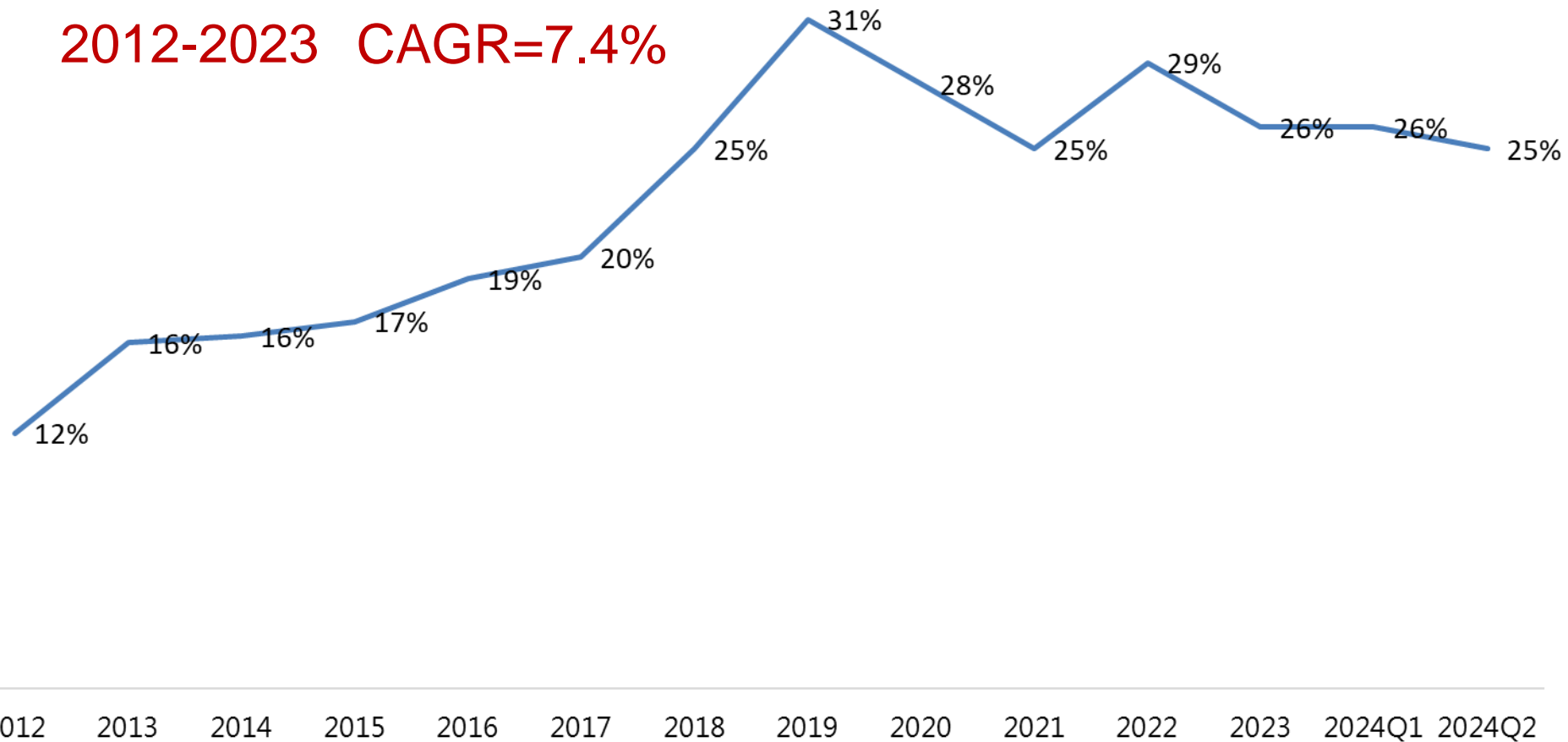
銀漿營收成長



歷年毛利率



2012-2023 CAGR=7.4%



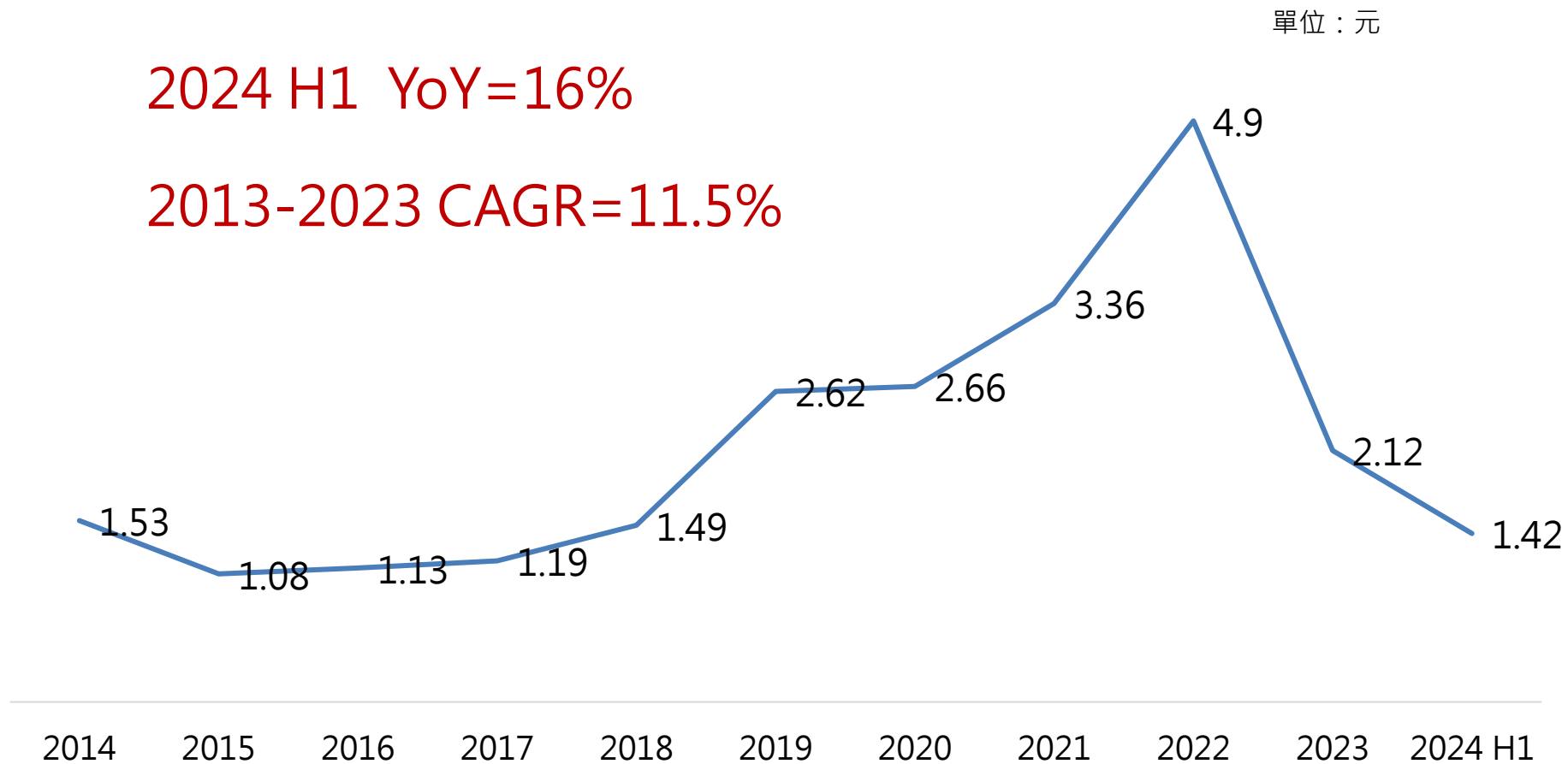
歷年每股稅後盈餘



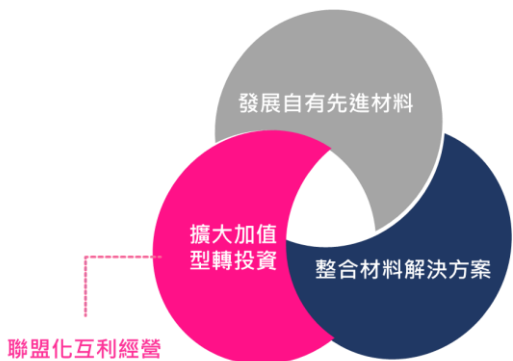
單位：元

2024 H1 YoY=16%

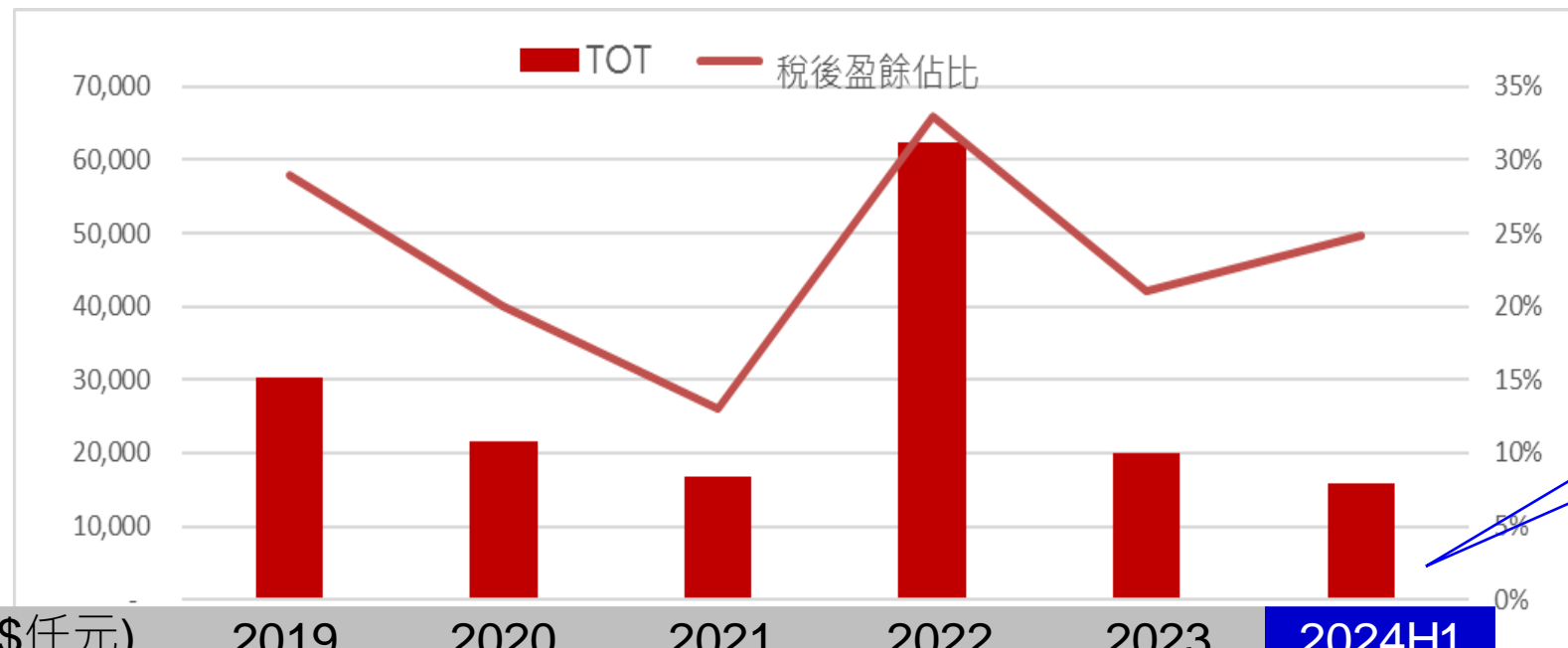
2013-2023 CAGR=11.5%



現有三大加值型轉投資長期穩定貢獻獲利



Simmtech 蘇州(STNS) 已由成本中心轉為利潤中心，佣金率提高。利機3月底持股由30%提升至49%。



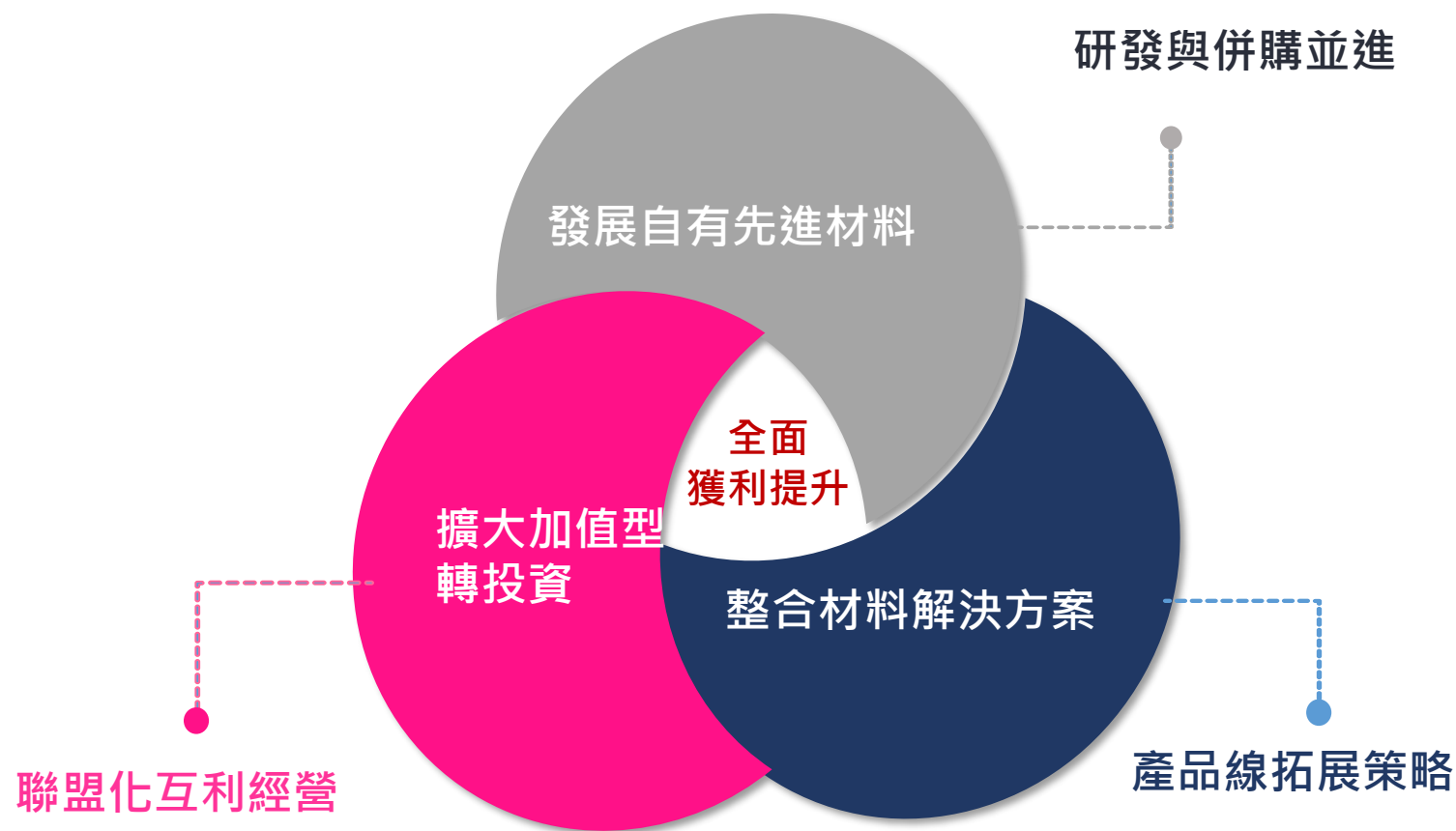
已達2023全年的80%

(NT\$千元)	2019	2020	2021	2022	2023	2024H1
精材	1,680	1,344	1,680	2,351	1,008	1,680
STNC	12,799	5,493	669	10,007	(3,521)	5,010
ENT	15,904	14,669	14,485	49,965	22,434	9,223
TOT	30,382	21,506	16,834	62,323	19,922	15,913
稅後盈餘佔比	29%	20%	13%	33%	21%	25%



營運展望

轉型全面提升獲利



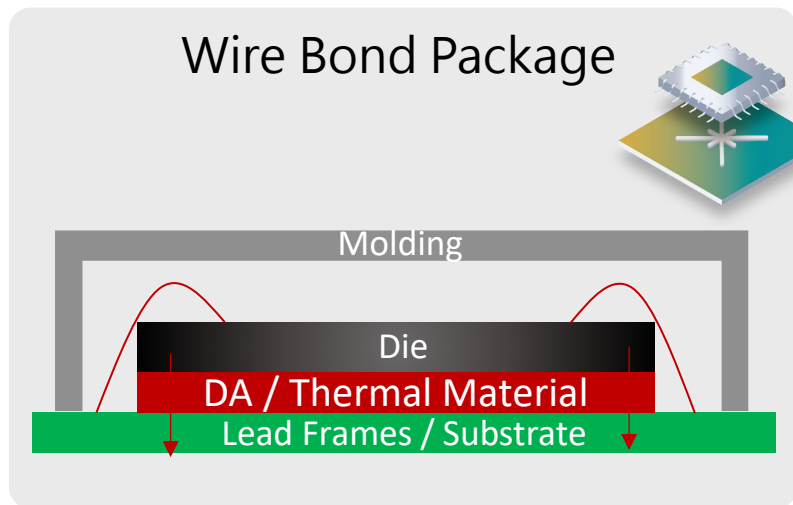
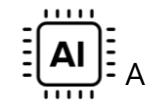
布局一：整合材料解決方案



IC散熱解決方案

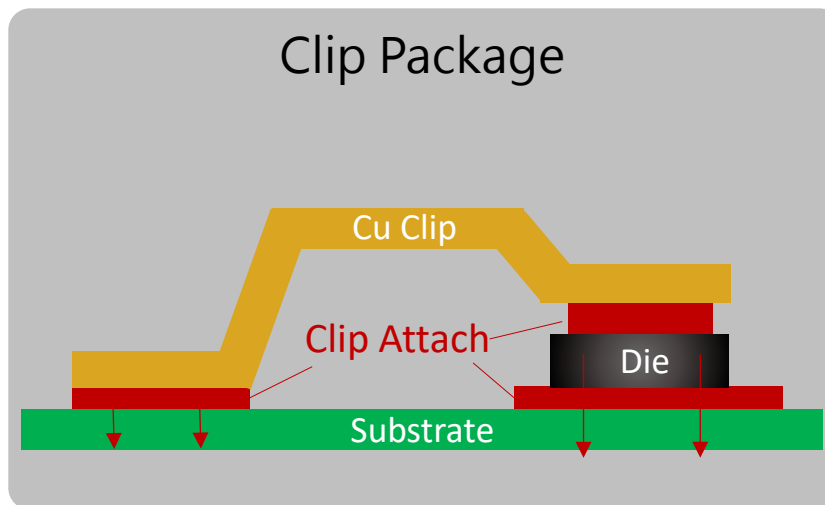


發展自有先進材料



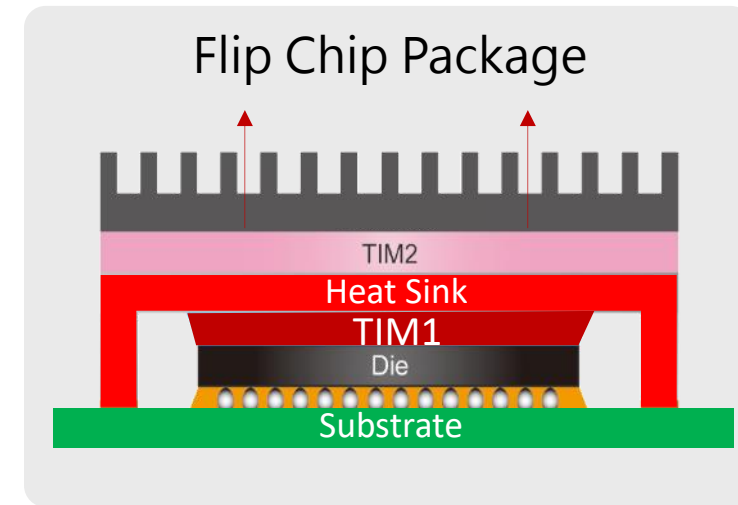
Die Attach Paste

(導熱銀膠、燒結銀膠)



Clip Attach Paste

(燒結銀膠)



TIM1、Heat Sink

(燒結銀膠)

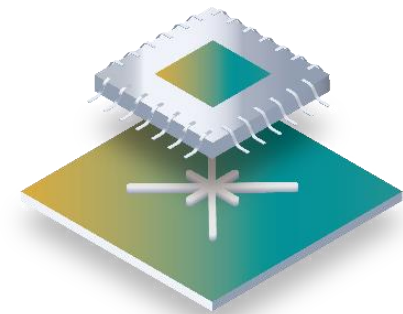
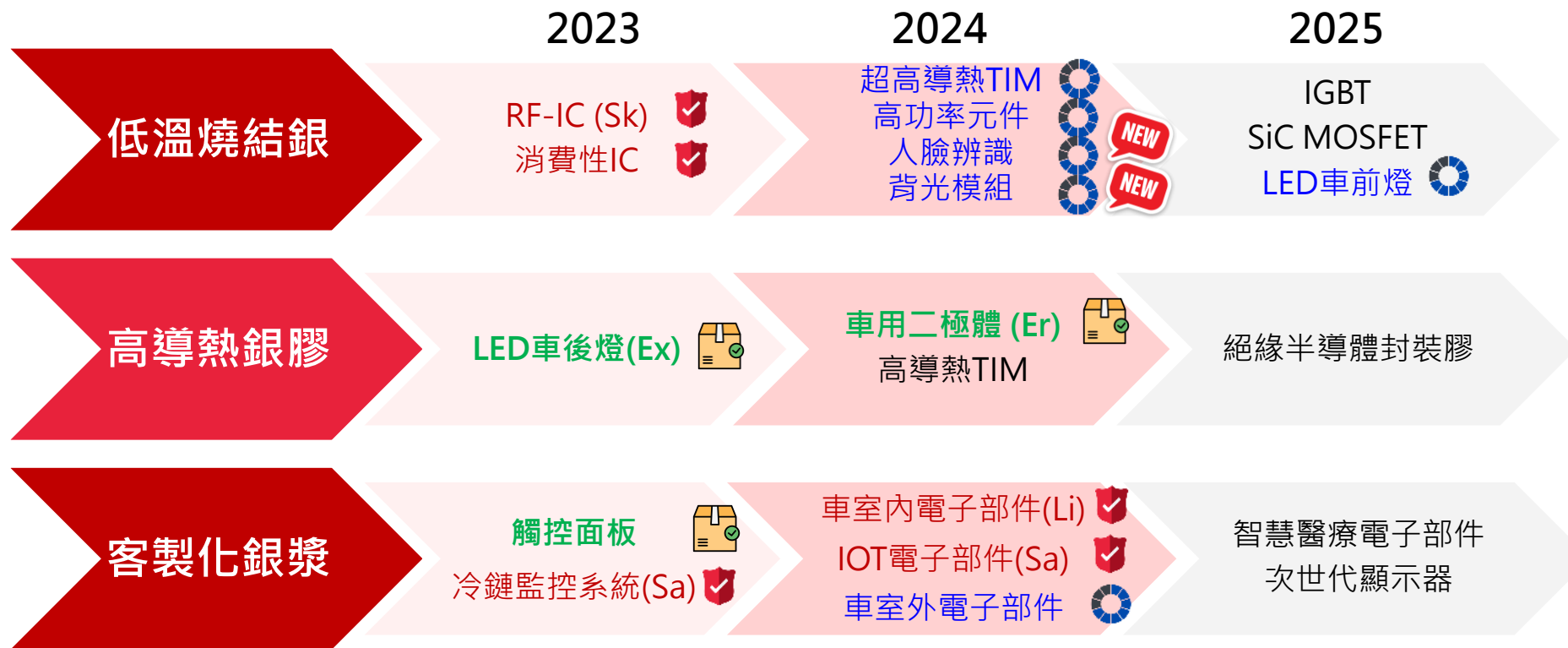


布局二：發展自有先進材料

1 自有研發

銀漿產品依發展藍圖推展順利

-  驗證通過
-  驗證進行中
-  量產



布局二：發展自有先進材料

1 自有研發 2024聚焦高功率元件、高運算散熱應用

- 客製化銀漿
- 低溫燒結銀
- 高導熱銀膠

高功率元件

車用電子

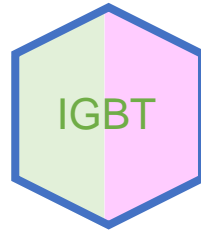


- 1. 高附著強度
- 2. 高信賴性

高功率
LED

- 1. 超高散熱性
($> 200 \text{ W/mk}$)
- 2. 高信賴性

高功率元件



- 1. 適用大尺寸
($> 5 \times 5 \text{ mm}$)晶片
- 2. 高散熱性
($> 150 \text{ W/mk}$)

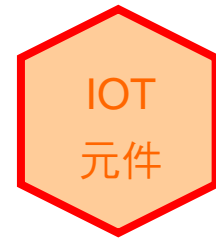
高運算散熱

AI



- 1. 高導熱性
- 2. 高韌性
- 3. 高信賴性

IOT



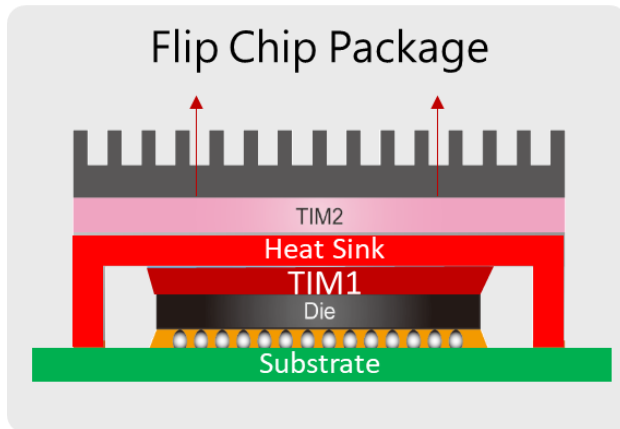
- 1. 快速固化
- 2. 高導電性

布局二：發展自有先進材料



2 併購Heat Sink均熱片廠商

1. 尺寸齊全、客製化生產，2024年聚焦大尺寸、先進封裝。
2. 透過併購布局不同製程，包括化學鍍鎳與電解鍍鎳，將可承接所有封裝客戶需求，服務更全面性。

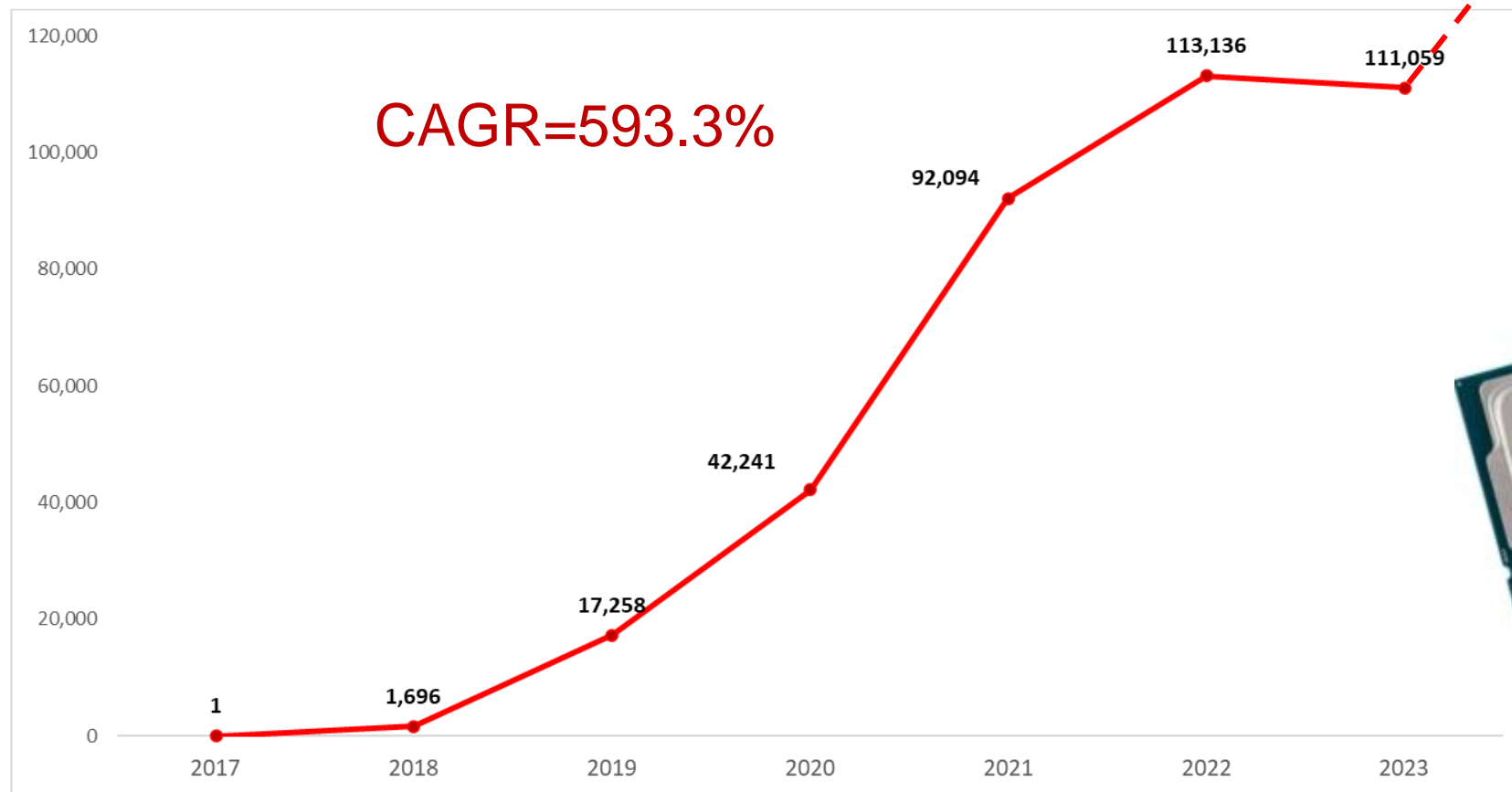


應用領域	尺寸	技術門檻	售價	利機優勢
消費性 IC	小片	低	低	• 具銅材/鋁材/不鏽鋼 高精密沖壓技術，客製化生產 • 台系封裝廠的合格供應商
Wireless AP	大片 40*40mm以上	高	高	
伺服器				
CPU/GPU				

均熱片歷年營收



單位：仟元



YOY>30%



總結



- 一. 連續四個月單月營收破億。累計1-8月已達2023年全年營收77%，表現優於市場預期，力拚全年營收再創新高。
- 二. 銀漿產品-聚焦高功率元件、高運算散熱。新增2客戶送樣中，高功率元件下半年獲新訂單。
- 三. 新產品-營運成長新動能
 - 1) 閥類-下半年有新產品上市，並有多家客戶驗證中。
 - 2) 切割刀-獲新訂單，package saw也有望取得與封裝大廠合作機會。
- 四. 加值型轉投資-上半年轉投資收益已達2023全年的80%，樂觀看待利機2024年度整體獲利向上。



THANK YOU

